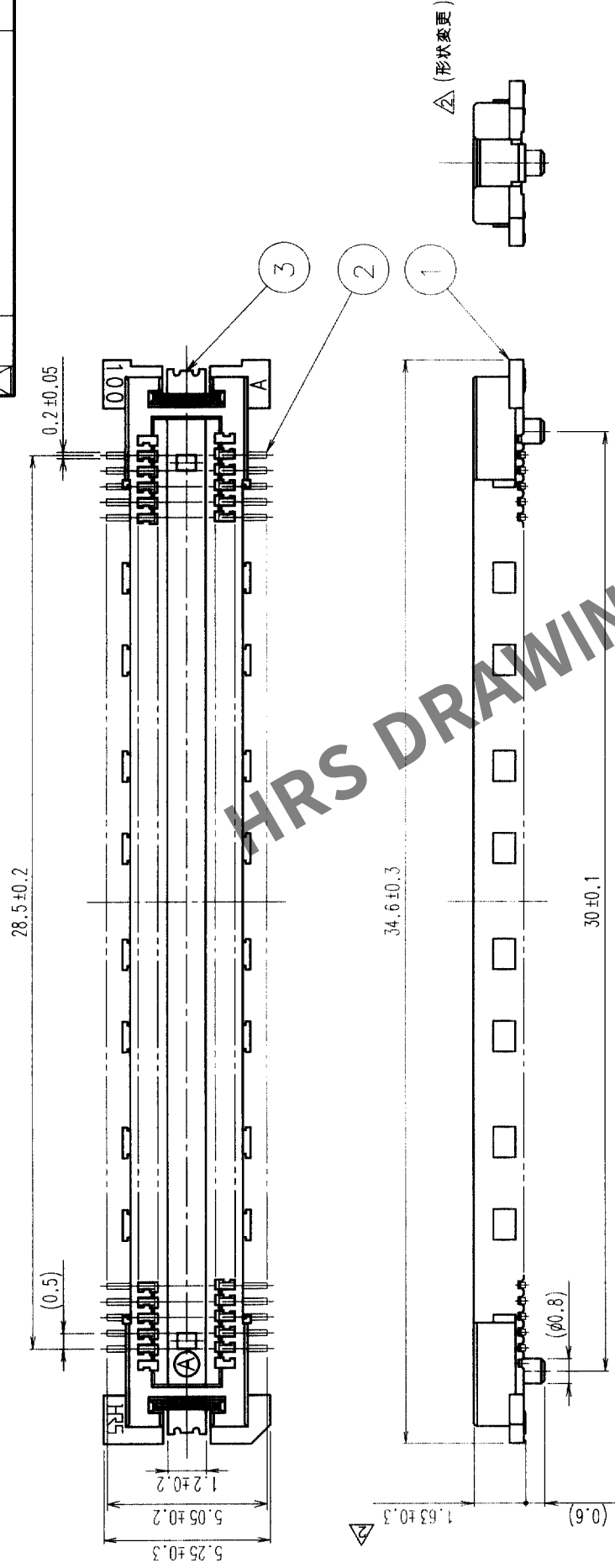
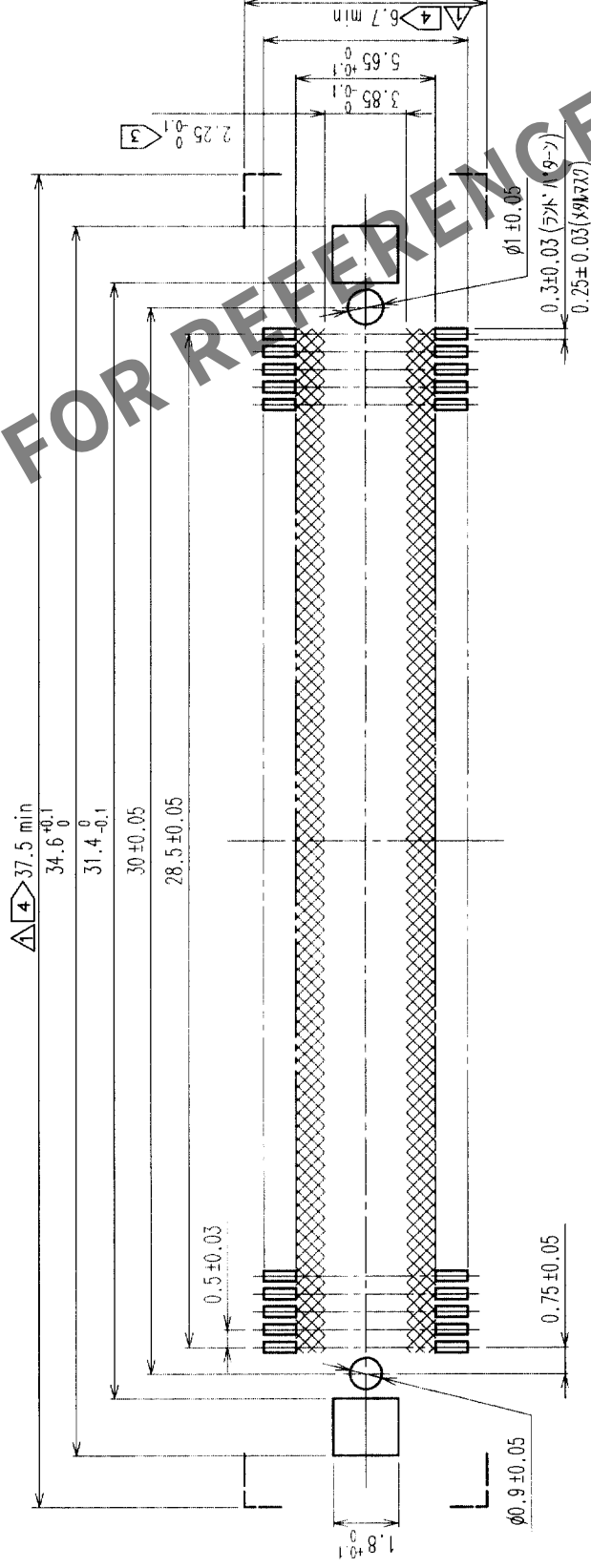


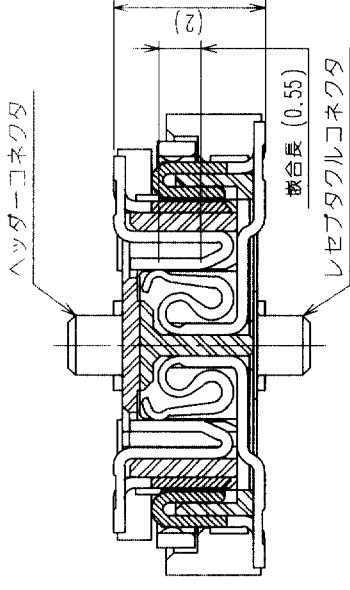
	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当係図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当係図 BY CHKD	年月日 DATE
A	3	RE-F-06374	松川 石田	99.05.15				.
A	3	RE-F-06562	松川	99.9.7				.
				.				.



図表 1 パーセント・ポイント



△2 信号断面图 (10:1)



2	銅合金	接觸形：ニッケル下地+金めっき0.1μ 結線形：ニッケル下地+金めっきフラッシュ
---	-----	---

1	LCP樹脂	ベージュ	UL94V-0	3	りん青銅	すずめっき
部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理、備考
備考	REMARKS					

	DRAWN	PCC 99.02.12 松川	DESIGNED	PCC 99.02.12 松川	CHECKED	PCC 99.02.12 吉村	APPROVED	PCC 99.02.12 吉村	RELEASED
--	-------	-----------------------	----------	-----------------------	---------	-----------------------	----------	-----------------------	----------

旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO. ADC3-152102	製品名 PART NO. FX11LA-116P-SV
 尺度 SCALE 5 : 1 単位 UNITS mm	 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品コード CODE NO. CL573-0044-7

注 1 本製品のSMTリードの平坦度は 0.1max となります。

2 本製品には基板装束上の属性はありません。

③ SMTランド内側の~~XXXX~~の範囲は、コネクタ端子と接触することがありますので、SMTランド幅からパターンが出ないようしてください。

④ この範囲内には、本製品以外の部品を搭載しないでください。相手コネクタとの接合ができなくなります。

TO	PCK			
----	-----	--	--	--